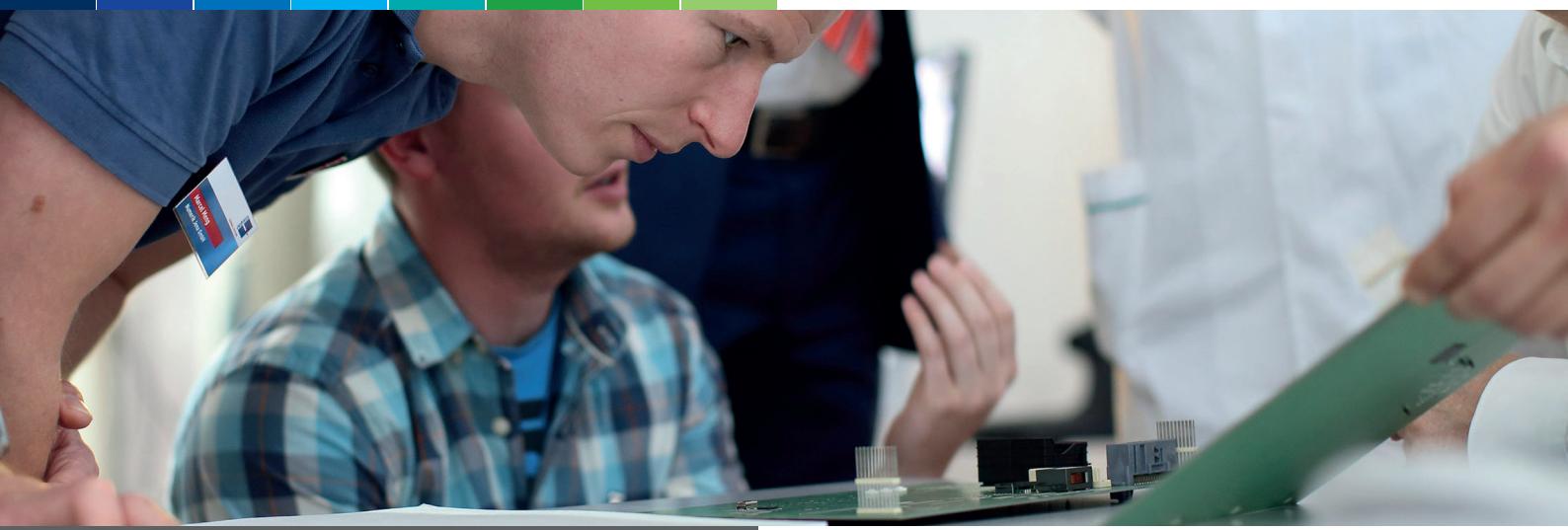


Temperaturprofilierung

Messmethoden und Wege zum optimalen Reflowlötprofil



22. Juli 2025 in Blaubeuren

Die Welt der elektronischen Baugruppen ist so vielfältig und komplex, dass es nicht möglich sein wird, alle spezifischen Bedürfnisse der Bauelemente und Materialien hinreichend abzubilden. Es bleibt also dem Sachverstand und Geschick des Fertigers überlassen, die optimalen Reflowparameter zu finden. Ausreichende Hinweise, Indizien und Erfahrungen sind jedoch vorhanden, um eine Optimierung zu ermöglichen. Entdecken Sie in unserem Seminar das Machbare vom Mythos zu unterscheiden. Der erste Teil dieses Seminars gibt Ihnen Einblick in die Grundlagen und die optimalen Parameter der Reflowprofilierung. Im zweiten Teil lernen Sie ein Messboard zu präparieren, den Nutzen einer Wärmebildkamera zu verstehen sowie Reflowprofile selbst zu erstellen.

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen

Schulungsdauer: 1 Tag

Teilnahmegebühr: 449 p.P. € inkl. Tagungsgetränken, Mittagessen, Schulungsunterlagen

09.15 Uhr	Begrüßung
09.30 Uhr	Grundlagen der Reflowprofilierung Normen, Messboards und Thermoelemente
10.45 Uhr	Praxis 1: Erstellung einer Reflow-Hüllkurve
11.15 Uhr	Kaffeepause
11.45 Uhr	Praxis 2: Messboard-Präparation (Technology Center)
13.00 Uhr	Mittagspause
13.45 Uhr	Praxis 3: Profilierung an der VisionXP+ (Technology Center)
15.00 Uhr	Kaffeepause
15.15 Uhr	Tipps & Tricks zur Präparation und Profilierung Einsatz der Wärmebildkamera, Fehler und Toleranzen
15.45 Uhr	Optimale Profilierung: Mythos oder Wahrheit? Vorstellung der Messergebnisse
16.30 Uhr	Ende des Seminars Zeit für Diskussion, Get-together und Firmenrundgänge

Vorbehaltlich inhaltlicher Anpassungen



TECHNOLOGY ACADEMY

Anmeldungsformular unter
www.rehm-group.com/aktuelles/termine